

お客様 各位

平成23年10月20日
株式会社ベルネット
代表取締役 長田 俊夫

「江戸・TOKYO技術とテクノの融合展2011」出展のお知らせ

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび表記の展示会において、「ソーシャルメディア連携 次世代デジタルサイネージ **ADGrid**」
(電子看板)を出品致します。

今回は、更なる新たな取り組みといたしまして、スマートフォンとの連動機能をデモンストレーション致します。
ご多忙中のところ誠に恐縮に存じますが、この機会に是非ご来臨賜り、ご高覧戴きたくご案内申し上げます。

敬具

記

- 1 日 時 平成23年11月2日(水) 10:00~17:00
- 2 場 所 東京国際フォーラム 展示ホール ブース G-14
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1 (入場無料)
- 3 展示イメージ
サイネージ端末として、話題のスマホを利用するシステムをご紹介します。

